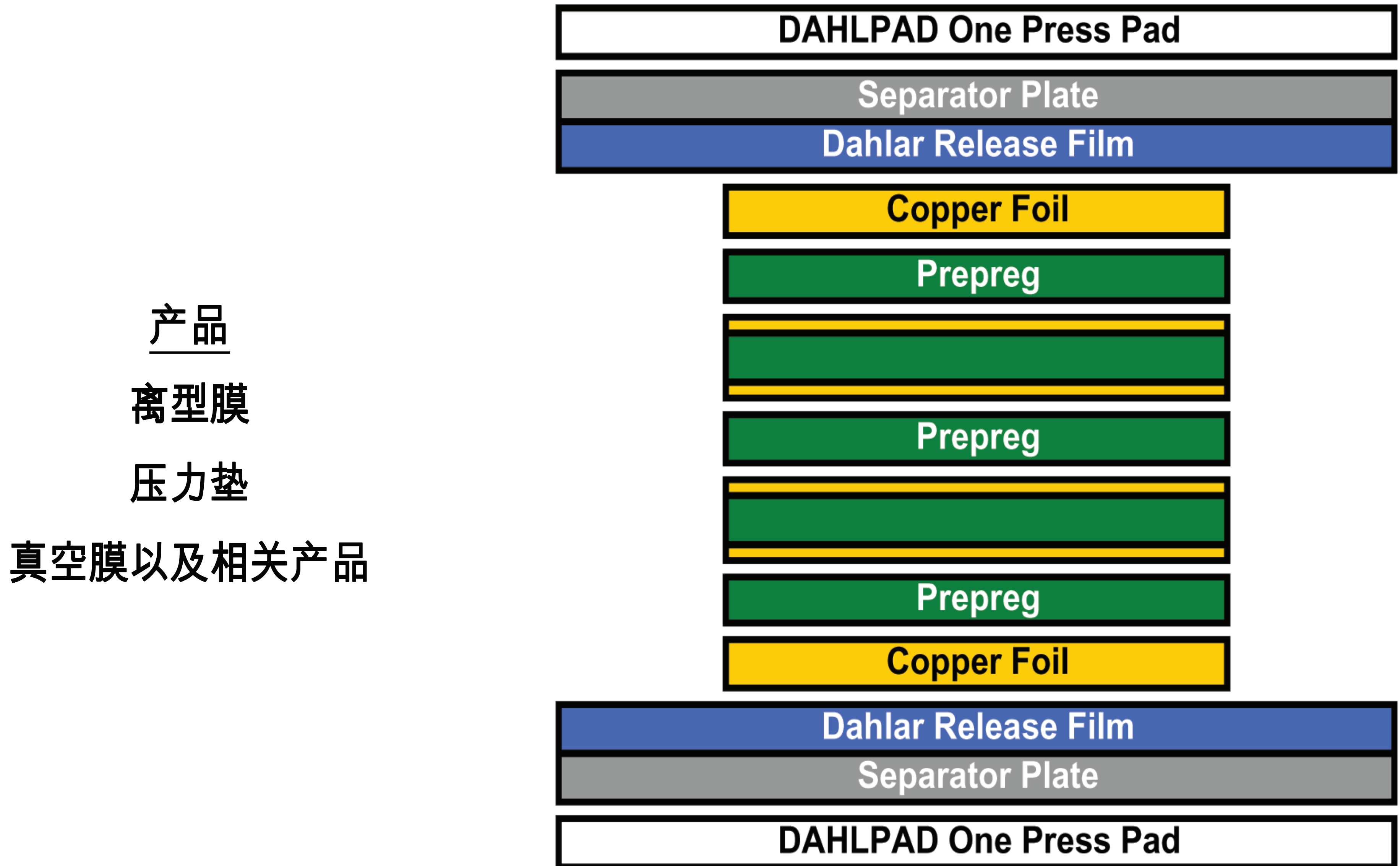
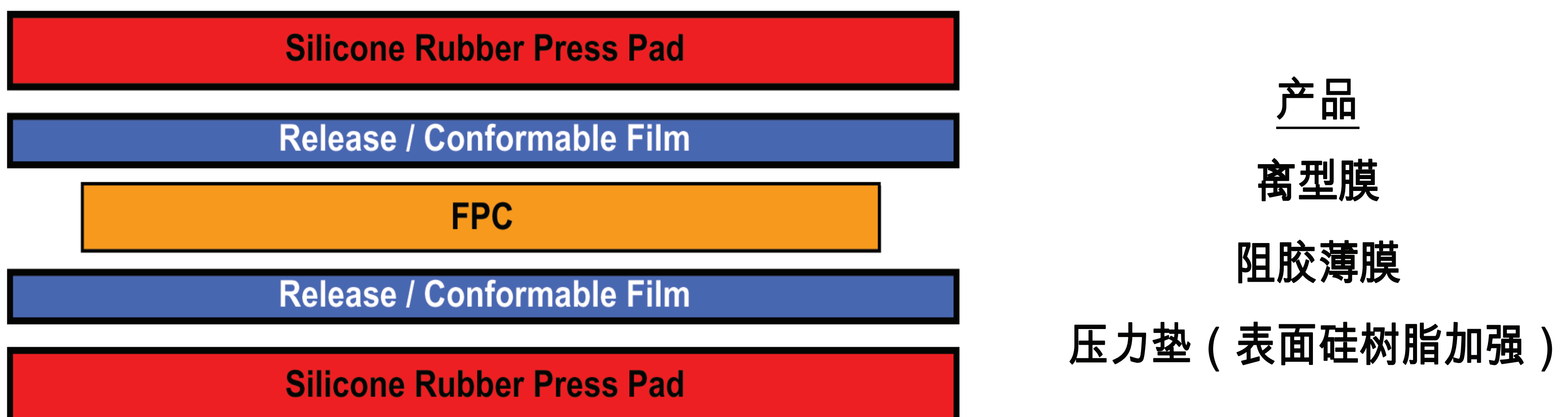


硬板压合工艺

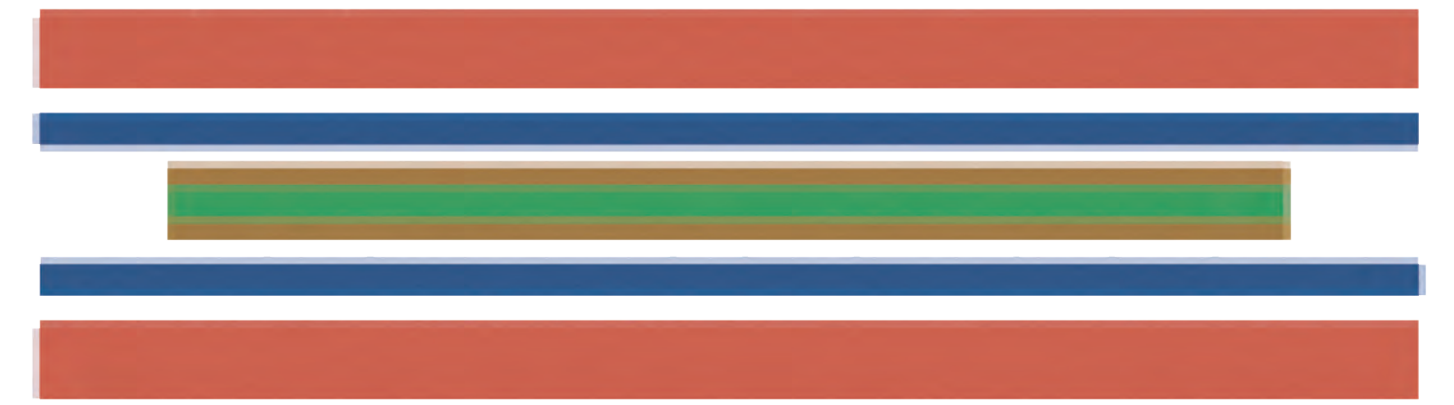


软板/软硬结合板压合工艺



软电路应用

要求：表面保护、一致性、易于释放
产品：DAHLAR 9301B, 9610NV, DAHLVIA 9100,
NCF 9500 Si-Pad, Si-Pad QL, 9950 TFNP



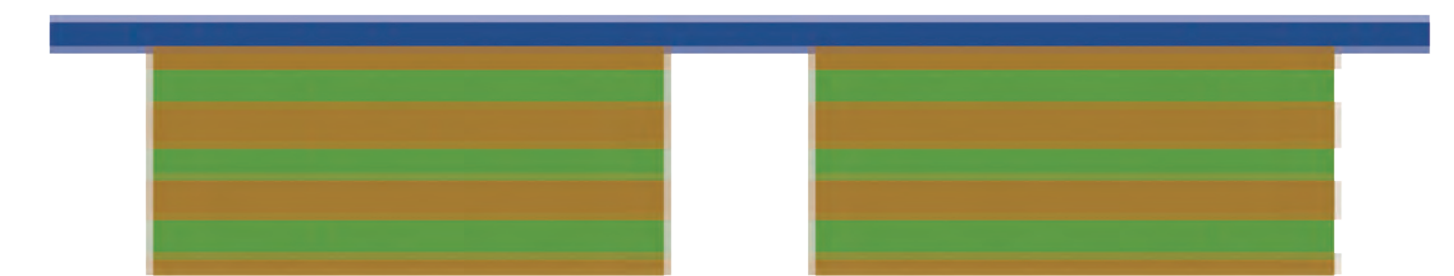
Masslam、CCL、应用

要求：表面保护，拆开易释放
产品：DAHLAR 9301B, 9000, NCF 9500



MLB、IVH 应用

要求：表面保护、拆开易释放、阻断树脂流动、
防止“粘合剂挤出”（柔性）
产品：DAHLAR 9301B、9000、DAHLVIA 9100、9173 MA



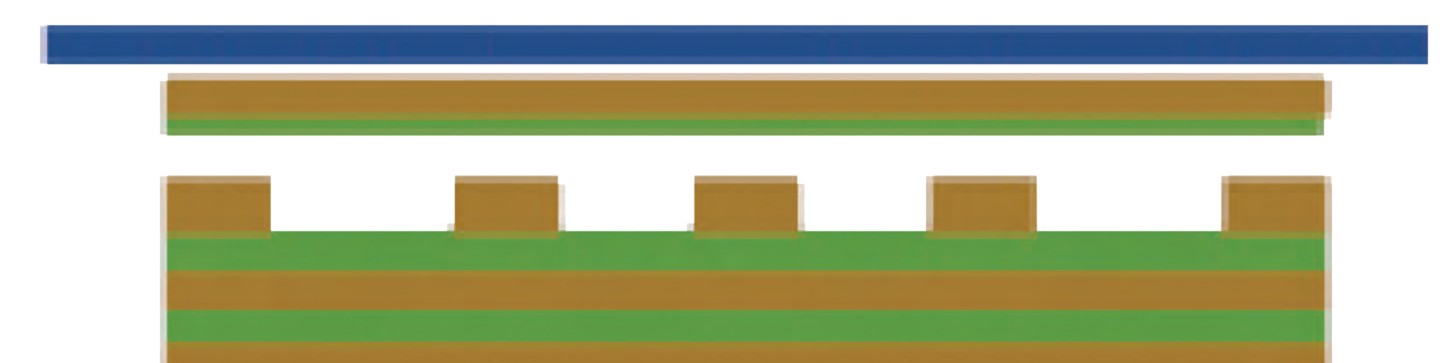
BGA 应用

要求：防止树脂溢出，同时保护重要表面。容易释放。
用我们的多层技术会降低成本
产品：DAHLVIA 9100、9173 MA、DAHLAR 9301B、9900



HDI-RCC 应用

要求：清除分层表面中的树脂，空洞拆开易释放
产品：DAHLVIA 9100, 9173 MA, 用于一致性 /
强化压力以推动树脂



刚柔应用

要求：防止树脂溢出，为不同表面提供保护，容易释放
产品：DAHLVIA 9100, 9173 MA

